



ASML 홀딩 (ASML.US)

2027년 큰 폭의 성장을 바라보는 ASML

- 3Q25CY 메모리 장비 매출액 반등, 신규 수주액은 +186%QoQ 급등
- 4Q25CY 가이드언스는 시장 컨센서스 상회
- AI 투자 수혜는 2026년 일부, 2027년부터 본격화될 것으로 기대

3Q25CY 메모리 신규 수주 급증

ASML 의 3Q25CY 실적이 매출액 €7.52B(-2%QoQ, +1%YoY)와 영업이익 €2.47B(-7%QoQ, +1%YoY)를 기록하며, 시장 컨센서스(매출액 €7.71B, 영업이익 €2.43B) 대비 매출액은 하회한 반면 영업이익은 상회했다. 주요 부문 중에서 ArF의 매출액 비중이 지난 분기의 43%에서 이번 분기 52%로 증가한 것이 수익성 개선의 주요 요인이었던 것으로 보인다. 다만 파운드리와 DRAM 선단 공정에 사용되는 EUV 장비의 매출 비중은 지난 분기의 48% 대비 크게 하락한 38%를 기록했다. 주요 전방 산업 중 Memory의 System 매출액이 €1.94B을 기록하며 오랜만에 반등을 보였고, Net System Bookings 금액도 €2.54(+186%QoQ)를 기록하며 큰 폭으로 증가했다.

4Q25CY 가이드언스, 시장 컨센서스 상회

4Q25CY 가이드언스는 매출액 €9.2~9.8B(+22~30%QoQ, -1%~+6%YoY)와 영업이익 €3.17~3.67B(+29~49%QoQ, -5%~+9%YoY)로 제시되며, 시장 컨센서스(매출액 €9.23B, 영업이익 €3.01B)를 크게 상회했다. 주요 사업 부문 중 Net System Sales 부문의 매출액 가이드언스가 시장 컨센서스를 크게 상회했는데, 이는 2대의 EUV 장비 매출 인식과 메모리 업체들의 전공정 투자 확대가 영향을 끼쳤을 것으로 판단된다.

2027년 큰 성장을 바라보는 ASML

ASML은 중국의 반도체 투자 금액이 하향 안정화될 것이라는 기존의 보수적인 시각을 유지했으며, 최근 들어 수많은 투자와 각 업체간의 협력 소식이 전해지고 있는 AI 산업과 관련해서는 2026년보다 2027년에 수혜가 클 것이라는 시각을 전달했다. 장비의 리드타임과 투자 계획이 현실화되기까지의 시점 차이 때문이다. 이는 "HBM의 수요가 2027년~2028년에 큰 폭으로 상승할 것이며, 이를 위한 생산 설비의 증가가 2026년 하반기부터 있을 것"이라는 당사의 판단에도 부합한다.

▶ 현재주가 / 목표주가 컨센서스

현재주가('25.10.16): \$1,019.59
 목표주가 컨센서스: \$988.66

▶ 투자 의견 컨센서스



Stock Data

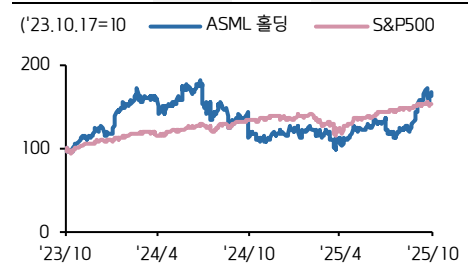
| 산업분류 | 반도체 & 반도체 장비 |
|-----------------|------------------|
| S&P 500 (10/16) | 6,629.07 |
| 현재주가/목표주가 | 1019.59 / 988.66 |
| 52주 최고/최저 (\$) | 1059.00 / 578.51 |
| 시가총액 (백만\$) | 396,619 |
| 유통주식 수 (백만) | 388 |
| 일평균거래량 (3M) | 1,899,040 |

Earnings & Valuation

| (백만 €) | FY23 | FY24 | FY25E | FY26E |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 매출액 | 27,559 | 28,263 | 32,603 | 34,012 |
| 영업이익 | 9,042 | 9,023 | 11,199 | 11,712 |
| OPM(%) | 32.8 | 31.9 | 34.3 | 34.4 |
| 순이익 | 7,839 | 7,572 | 9,545 | 9,908 |
| EPS | 19.9 | 19.2 | 24.6 | 26.1 |
| 증가율(%) | 40.8 | -3.3 | 27.8 | 6.2 |
| PER(배) | 35.1 | 33.2 | 41.1 | 38.7 |
| PBR(배) | 20.1 | 14.2 | 20.5 | 17.7 |
| ROE(%) | 70.4 | 47.4 | 48.5 | 46.3 |
| 배당수익률(%) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |

Performance & Price Trend

| 주가수익률 (%) | YTD | 1M | 6M | 12M |
|-----------|------|------|------|------|
| 절대 | 47.1 | 16.1 | 60.6 | 49.2 |
| S&P Index | 13.4 | 0.8 | 23.6 | 14.7 |



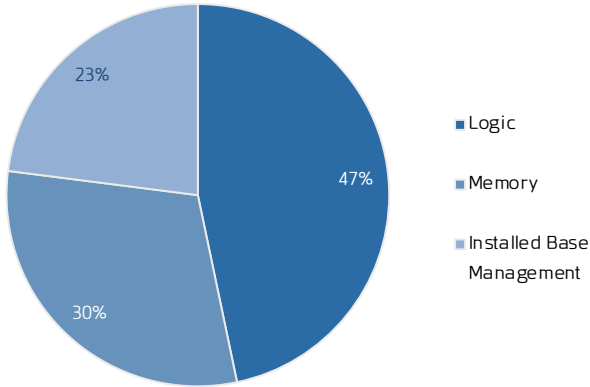
자료: 데이터 스트림 컨센서스, 키움증권 리서치센터

ASML 홀딩 실적 추이 및 전망 (단위: 백만유로)

| | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25E | 2023 | 2024 | 2025E |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 매출액 | 5,290 | 6,243 | 7,467 | 9,263 | 7,742 | 7,692 | 7,516 | 9,384 | 27,558 | 28,263 | 32,333 |
| %QoQ/%YoY | -27% | 18% | 20% | 24% | -16% | -1% | -2% | 25% | 30% | 3% | 14% |
| Net System Sales | 3,966 | 4,761 | 5,926 | 7,116 | 5,740 | 5,596 | 5,554 | 7,266 | 21,939 | 21,769 | 24,156 |
| %QoQ/%YoY | -30% | 20% | 24% | 20% | -19% | -3% | -1% | 31% | 42% | -1% | 11% |
| Revenue By End-Use | | | | | | | | | | | |
| Logic | 2,499 | 2,571 | 3,793 | 4,341 | 3,329 | 3,861 | 3,610 | 4,880 | 16,063 | 13,203 | 15,681 |
| %QoQ/%YoY | -30% | 3% | 48% | 14% | -23% | 16% | -7% | 35% | 60% | -18% | 19% |
| Memory | 1,467 | 2,190 | 2,133 | 2,775 | 2,411 | 1,735 | 1,944 | 2,582 | 5,876 | 8,566 | 8,671 |
| %QoQ/%YoY | -30% | 49% | -3% | 30% | -13% | -28% | 12% | 33% | 9% | 46% | 1% |
| Revenue By Technology | | | | | | | | | | | |
| EUV | 1,824 | 1,466 | 2,074 | 2,957 | 3,215 | 2,686 | 2,110 | 2,784 | 9,124 | 8,321 | 10,795 |
| %QoQ/%YoY | -21% | -20% | 41% | 43% | 9% | -16% | -21% | 32% | 29% | -9% | 30% |
| ArFi | 1,547 | 2,370 | 2,844 | 2,906 | 1,894 | 2,406 | 2,888 | 3,112 | 9,017 | 9,667 | 10,301 |
| %QoQ/%YoY | -27% | 53% | 20% | 2% | -35% | 27% | 20% | 8% | 72% | 7% | 7% |
| ArF Dry | 119 | 307 | 178 | 171 | 115 | 112 | 111 | 240 | 780 | 774 | 578 |
| %QoQ/%YoY | -60% | 158% | -42% | -4% | -33% | -3% | -1% | 116% | 26% | -1% | -25% |
| KrF | 317 | 426 | 593 | 655 | 287 | 224 | 167 | 530 | 2,203 | 1,991 | 1,208 |
| %QoQ/%YoY | -54% | 34% | 39% | 11% | -56% | -22% | -26% | 218% | 31% | -10% | -39% |
| I-Line | 40 | 112 | 119 | 99 | 57 | 56 | 56 | 109 | 278 | 369 | 278 |
| %QoQ/%YoY | -66% | 181% | 6% | -16% | -42% | -3% | -1% | 97% | 57% | 33% | -25% |
| Metrology&Inspection | 119 | 80 | 119 | 328 | 172 | 112 | 222 | 211 | 536 | 646 | 718 |
| %QoQ/%YoY | -24% | -33% | 48% | 177% | -48% | -35% | 98% | -5% | -16% | 20% | 11% |
| Installed Base Management | 1,324 | 1,482 | 1,541 | 2,147 | 2,001 | 2,096 | 1,962 | 2,031 | 5,620 | 6,494 | 8,090 |
| %QoQ/%YoY | -15% | 12% | 4% | 39% | -7% | 5% | -6% | 4% | -2% | 16% | 25% |
| 매출원가 | 2,593 | 3,031 | 3,674 | 4,473 | 3,562 | 3,562 | 3,636 | 4,569 | 13,422 | 13,771 | 15,328 |
| 매출원가율 | 49% | 49% | 49% | 48% | 46% | 46% | 48% | 49% | 49% | 49% | 47% |
| 매출총이익 | 2,697 | 3,212 | 3,793 | 4,790 | 4,180 | 4,130 | 3,880 | 4,815 | 14,136 | 14,492 | 17,005 |
| 판매비와 관리비 | 273 | 277 | 297 | 318 | 281 | 299 | 303 | 322 | 1,113 | 1,166 | 1,204 |
| 영업이익 | 1,391 | 1,835 | 2,441 | 3,356 | 2,738 | 2,664 | 2,468 | 3,263 | 9,042 | 9,023 | 11,133 |
| %QoQ/%YoY | -42% | 32% | 33% | 37% | -18% | -3% | -7% | 32% | 39% | 0% | 23% |
| 영업이익률 | 26% | 29% | 33% | 36% | 35% | 35% | 33% | 35% | 33% | 32% | 34% |
| 법인세차감전순이익 | 1,418 | 1,823 | 2,440 | 3,362 | 2,787 | 2,689 | 2,488 | 3,312 | 9,084 | 9,042 | 11,276 |
| 법인세비용 | 194 | 245 | 364 | 668 | 432 | 399 | 363 | 652 | 1,244 | 1,471 | 1,846 |
| 당기순이익 | 1,224 | 1,578 | 2,077 | 2,693 | 2,355 | 2,290 | 2,125 | 2,660 | 7,840 | 7,572 | 9,429 |
| 당기순이익률 | 23% | 25% | 28% | 29% | 30% | 30% | 28% | 28% | 28% | 27% | 29% |
| CapEx | 417 | 531 | 415 | 704 | 415 | 415 | 296 | 544 | 2,156 | 2,067 | 1,669 |
| %QoQ/%YoY | -29% | 27% | -22% | 70% | -41% | 0% | -29% | 84% | 68% | -4% | -19% |

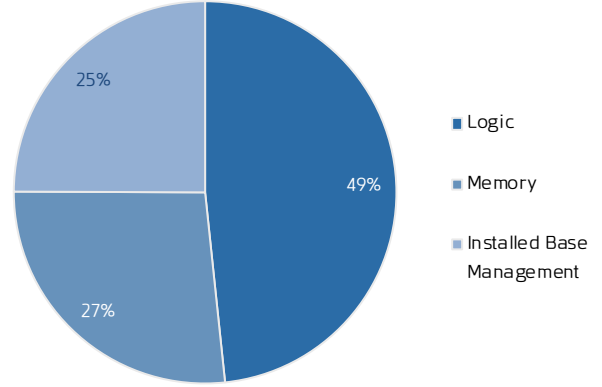
주: 실적 전망치는 Bloomberg 컨센서스 기준 (기준일: 2025/10/15). 실적은 Non-GAAP, CY 기준 (회계 기준 결산일은 12/31일)
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2024CY ASML 홀딩 매출액 비중



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

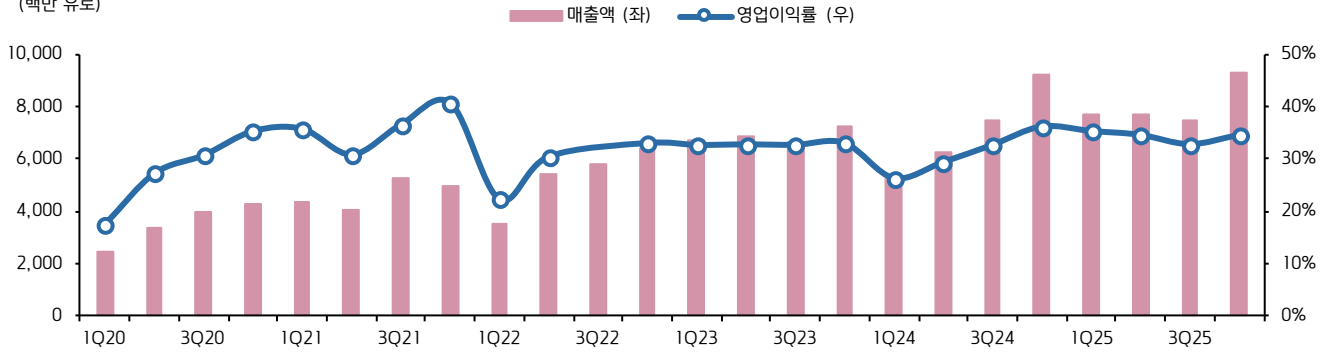
2025CY ASML 홀딩 매출액 비중 전망



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

ASML 홀딩 매출액 및 영업이익률 추이

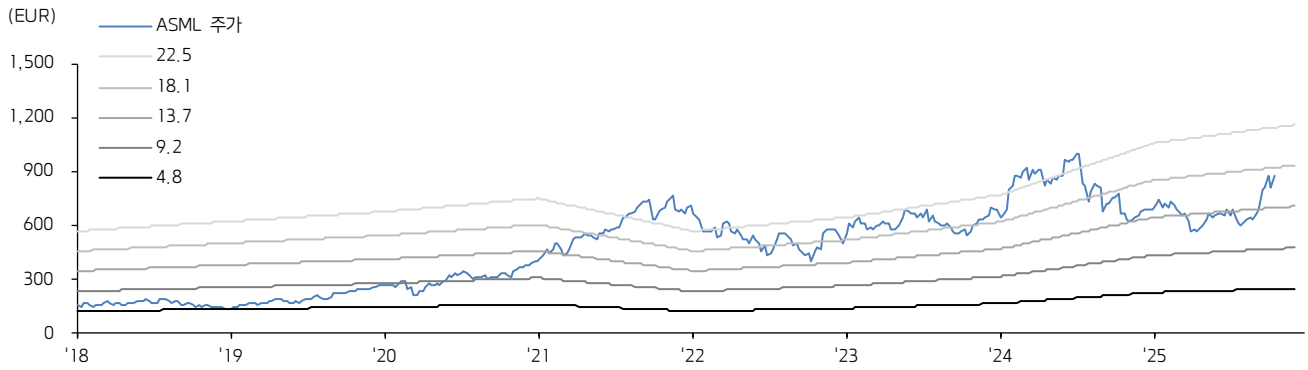
(백만 유로)



주: 실적 전망치는 Bloomberg 컨센서스 기준 (기준일: 2025/10/16)

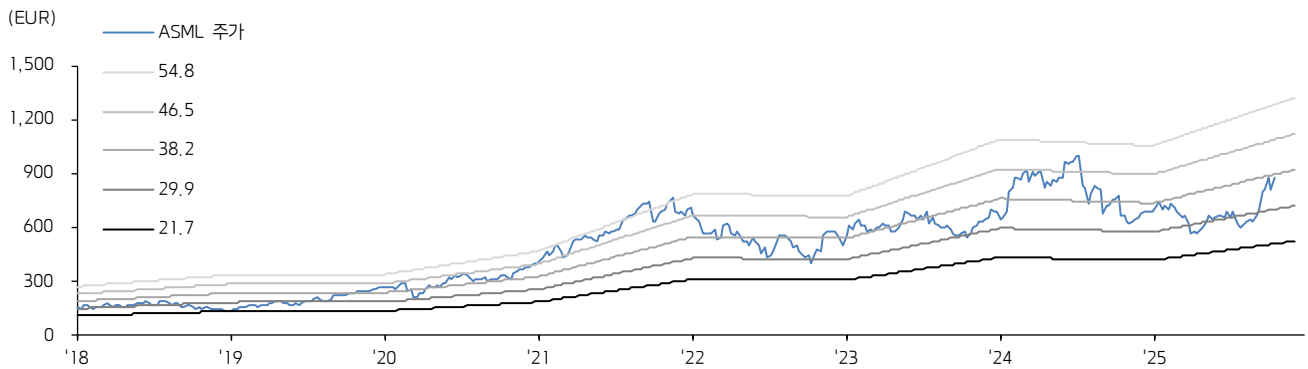
자료: ASML 홀딩, 키움증권 리서치센터

ASML 홀딩 12개월 Trailing P/B Chart



주: 10/16 종가 기준
자료: 키움증권 리서치센터

ASML 홀딩 12개월 Trailing P/E Chart







주: 10/16 종가 기준
자료: 키움증권 리서치센터

글로벌 Tech 기업 주가 및 Valuation

| (십억달러, 배, %) | | Mkt Cap | %CHG | | | | P/E | | P/B | | EV/EBITDA | | Rev | | OP | | EBITDA | | ROE | | |
|--------------|-----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| | | ID | 5D | 1M | 3M | 6M | 2025E | 2026E | 2025E | 2026E | 2025E | 2026E | 2025E | 2026E | 2025E | 2026E | 2025E | 2026E | 2025E | 2026E | |
| Memory | Micron | 227.3 | 5.5 | 5.3 | 27.5 | 74.0 | 192.1 | 18.3 | 11.1 | 3.8 | 2.9 | 9.9 | 6.6 | 43.0 | 57.4 | 13.7 | 24.5 | 23.4 | 33.3 | 20.5 | 26.1 |
| | Sandisk | 21.1 | -0.0 | 11.3 | 57.6 | 248.8 | 350.4 | 56.2 | 15.8 | 2.2 | 2.0 | 26.1 | 10.4 | 8.1 | 9.8 | -1.3 | 1.9 | 0.8 | 2.1 | -2.5 | 13.9 |
| | Kioxia | 24.7 | 8.9 | 17.0 | 55.0 | 185.0 | 275.1 | 22.7 | 7.3 | 4.1 | 2.9 | 6.3 | 4.5 | 11.6 | 13.4 | 1.9 | 4.2 | 4.7 | 5.8 | 28.6 | 36.7 |
| | Seagate | 48.1 | 3.0 | 2.0 | 7.1 | 53.6 | 210.4 | 23.7 | 18.9 | 308.0 | 29.2 | 17.9 | 13.8 | 9.8 | 11.2 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | -0.6 | 251.9 |
| | Western Digital | 43.2 | 4.5 | 5.2 | 22.1 | 89.3 | 253.5 | 19.9 | 17.8 | 6.7 | 5.1 | 13.8 | 11.0 | 10.5 | 11.7 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 32.7 | 38.1 |
| | Nanya | 9.6 | 10.0 | 4.5 | 29.5 | 120.2 | 195.6 | 790.8 | 11.0 | 1.8 | 1.5 | 19.4 | 5.1 | 2.0 | 3.4 | -0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 14.5 |
| Logic | Intel | 171.4 | -0.8 | -2.5 | 45.8 | 62.4 | 91.6 | 244.0 | 55.1 | 1.5 | 1.5 | 16.9 | 12.0 | 52.0 | 53.8 | 1.2 | 4.8 | 12.9 | 16.4 | -0.6 | 2.1 |
| | Nvidia | 4418.0 | 1.1 | -5.6 | 4.0 | 6.1 | 74.0 | 40.5 | 28.7 | 31.5 | 17.9 | 32.9 | 22.8 | 200.0 | 275.0 | 121.3 | 183.5 | 132.3 | 186.5 | 91.8 | 76.2 |
| | AMD | 380.7 | -1.7 | 0.7 | 46.2 | 46.5 | 165.7 | 59.4 | 37.4 | 6.2 | 5.6 | 51.6 | 32.2 | 33.1 | 41.6 | 7.2 | 11.1 | 8.0 | 11.9 | 8.4 | 13.0 |
| | Broadcom | 1672.4 | 0.8 | 2.6 | -1.6 | 26.1 | 102.8 | 51.2 | 35.9 | 21.2 | 16.3 | 39.1 | 28.0 | 65.4 | 90.5 | 33.3 | 59.6 | 43.7 | 60.2 | 42.3 | 48.4 |
| | Marvell | 76.1 | -0.7 | -2.7 | 28.1 | 24.5 | 69.9 | 32.2 | 26.5 | 5.2 | 4.8 | 24.8 | 21.2 | 8.0 | 9.3 | 1.9 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 5.3 | 3.6 |
| | Qualcomm | 177.0 | 0.7 | -1.0 | -0.0 | 6.5 | 20.9 | 14.0 | 13.6 | 6.1 | 5.5 | 11.2 | 10.8 | 43.5 | 44.5 | 13.6 | 15.1 | 16.0 | 16.3 | 43.8 | 39.5 |
| | Arm | 181.3 | 0.3 | 0.3 | 11.3 | 11.2 | 69.5 | 108.3 | 77.9 | 23.0 | 18.2 | 85.2 | 61.5 | 4.5 | 5.6 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 17.0 | 20.1 |
| | Skyworks | 11.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 33.3 | 14.2 | 17.1 | 2.1 | 2.2 | N/A | N/A | 3.9 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 11.3 | 9.2 |
| | TI | 159.5 | 0.1 | -1.9 | -1.2 | -19.0 | 19.7 | 29.3 | 25.7 | 9.6 | 9.1 | 21.1 | 17.9 | 17.7 | 19.5 | 6.1 | 7.3 | 8.0 | 9.5 | 30.6 | 35.8 |
| | ADI | 118.9 | 1.5 | 1.6 | -1.0 | 0.4 | 37.3 | 29.7 | 24.9 | 3.5 | 3.4 | 20.6 | 18.3 | 11.3 | 12.6 | 3.8 | 5.7 | 6.0 | 6.8 | 9.3 | 11.8 |
| | NXP | 54.8 | 0.1 | -1.8 | -1.6 | -1.4 | 29.0 | 18.4 | 15.4 | 5.6 | 4.9 | 13.7 | 11.8 | 12.2 | 13.3 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 28.5 | 32.6 |
| | STMicro | 26.7 | 1.3 | 2.2 | 7.7 | -7.9 | 45.8 | 46.6 | 20.8 | 1.5 | 1.4 | 10.3 | 7.0 | 11.8 | 13.3 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 3.4 | 3.1 | 6.9 |
| | Microchip | 35.3 | 0.2 | -0.8 | 1.4 | -12.2 | 72.2 | 58.9 | 28.1 | 5.7 | 5.5 | 30.3 | 18.7 | 4.4 | 5.4 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 7.7 | 18.4 |
| | On Semi | 21.7 | 5.2 | 6.0 | 6.9 | -11.0 | 54.7 | 23.1 | 18.1 | 2.8 | 2.6 | 13.6 | 11.9 | 6.0 | 6.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 9.2 | 14.8 |
| | Silicon Motion | 3.1 | -0.3 | -1.9 | 2.3 | 29.5 | 131.8 | 27.2 | 19.4 | 3.7 | 3.3 | 19.3 | 13.8 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 12.9 | 17.9 |
| Mediatek | 69.5 | 1.1 | -0.4 | -11.9 | -4.3 | -0.7 | 19.9 | 17.5 | 5.4 | 5.0 | 14.7 | 13.1 | 19.1 | 21.3 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 27.0 | 29.5 | |
| Renesas | 24.1 | 8.2 | 5.2 | 10.9 | 1.8 | 19.3 | 12.6 | 9.9 | 1.5 | 1.4 | 13.3 | 10.0 | 8.6 | 9.4 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 0.5 | 9.7 | |
| Novatek | 8.2 | 1.0 | -3.4 | -3.2 | -17.8 | -16.4 | 15.2 | 13.0 | 3.8 | 3.6 | 9.7 | 8.8 | 3.3 | 3.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 24.9 | 28.1 | |
| Foundry | TSMC | 1555.1 | -1.6 | -0.0 | 14.4 | 26.2 | 97.7 | 29.8 | 25.2 | 9.0 | 7.2 | 17.9 | 14.9 | 122.2 | 146.1 | 59.5 | 70.7 | 84.0 | 99.3 | 32.7 | 31.1 |
| | SMIC | 92.8 | -2.8 | -11.5 | 9.2 | 59.6 | 60.7 | 106.8 | 73.7 | 3.5 | 3.3 | 24.6 | 20.8 | 9.3 | 11.0 | 0.8 | 1.2 | 4.5 | 5.4 | 3.3 | 4.5 |
| | UMC | 18.7 | 0.1 | -0.7 | 8.8 | -0.1 | 8.5 | 20.7 | 17.2 | 0.2 | 0.1 | N/A | N/A | 7.7 | 8.1 | 1.3 | 1.5 | 3.3 | 3.7 | 9.9 | 11.2 |
| | GFS | 19.2 | -1.5 | -2.1 | 8.0 | -13.7 | 9.3 | 21.6 | 17.2 | 1.6 | 1.5 | 7.0 | 5.8 | 6.8 | 7.3 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 8.0 | 9.2 |
| | VIS | 6.1 | 2.2 | -2.9 | 8.7 | 6.4 | 11.1 | 22.9 | 22.1 | 2.7 | 2.6 | 10.9 | 10.8 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 12.0 | 12.4 |
| Packaging | ASE | 27.8 | 5.4 | 7.4 | 11.3 | 20.7 | 53.2 | 23.2 | 15.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.6 | 22.9 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 11.5 | N/A |
| | Amkor | 7.8 | 0.7 | 2.8 | 16.5 | 48.4 | 95.0 | 27.7 | 20.5 | 1.7 | 1.6 | 6.9 | 5.9 | 6.6 | 7.0 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 6.3 | 8.2 |
| | Agilent | 40.0 | 1.0 | 0.7 | 10.9 | 24.4 | 37.4 | 25.0 | 23.1 | 5.9 | 5.3 | 20.5 | 18.9 | 7.0 | 7.3 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 24.4 | 23.4 |
| | Chipbond | 1.4 | 0.7 | 2.0 | 6.1 | 3.4 | -1.7 | 13.3 | 13.2 | 0.9 | 0.9 | 5.2 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 7.4 | 7.3 |
| | ASML | 395.8 | 1.0 | 4.0 | 16.1 | 35.1 | 60.6 | 35.6 | 33.9 | 16.8 | 14.1 | 27.3 | 25.9 | 37.8 | 39.4 | 13.0 | 13.5 | 14.2 | 14.9 | 49.5 | 45.1 |
| Equipment | AMAT | 181.4 | 0.1 | 3.4 | 31.2 | 16.9 | 64.8 | 24.7 | 23.3 | 9.3 | 8.4 | 20.5 | 19.3 | 28.0 | 29.7 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 37.4 | 37.0 |
| | LAM Research | 179.5 | -1.7 | 1.0 | 18.2 | 41.8 | 118.6 | 30.7 | 29.7 | 16.6 | 13.5 | 25.4 | 24.4 | 20.0 | 21.0 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 56.0 | 53.6 |
| | TEL | 94.8 | 4.1 | 3.4 | 24.7 | 8.9 | 52.7 | 27.0 | 24.6 | 7.0 | 6.3 | 18.9 | 15.8 | 16.0 | 17.0 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 26.0 | 25.3 |
| | KLA | 144.7 | 1.1 | 4.3 | 10.9 | 17.7 | 71.1 | 31.5 | 29.7 | 26.7 | 20.3 | 25.1 | 23.9 | 12.6 | 13.4 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 93.2 | 80.0 |
| | AMEC | 24.1 | 0.1 | -14.0 | 20.8 | 54.0 | 43.3 | 77.4 | 53.0 | 7.8 | 6.9 | 69.5 | 45.5 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 10.3 | 13.4 |
| | Naura | 41.7 | -0.4 | -10.3 | 5.5 | 28.9 | 19.7 | 39.3 | 30.3 | 7.8 | 6.0 | 31.5 | 23.5 | 5.4 | 6.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 20.4 | 21.6 |
| | Linde | 207.2 | -2.4 | -4.7 | -4.9 | -4.3 | -3.3 | 26.9 | 24.6 | 5.3 | 5.0 | 17.0 | 16.0 | 33.9 | 35.7 | 10.0 | 10.8 | 13.3 | 14.2 | 19.6 | 20.4 |
| | Air Liquid | 117.7 | 1.6 | 1.5 | -0.3 | 0.5 | -0.4 | 26.5 | 23.8 | 3.5 | 3.3 | 13.4 | 12.4 | 31.8 | 33.2 | 6.6 | 7.2 | 9.6 | 10.3 | 14.0 | 14.8 |
| Materials | Air Products | 56.3 | -1.6 | -3.6 | -11.1 | -12.4 | -3.1 | 20.7 | 19.1 | 3.2 | 2.9 | 14.2 | 13.3 | 12.2 | 12.8 | 0.0 | 3.3 | 5.2 | 5.6 | 16.3 | 16.1 |
| | Merck KGaA | 56.8 | -4.0 | -5.3 | 5.1 | 1.3 | -5.7 | 13.4 | 12.5 | 1.5 | 1.4 | 9.3 | 8.6 | 24.7 | 25.6 | 4.5 | 4.9 | 7.0 | 7.3 | 10.8 | 10.6 |
| | ADEKA | 2.3 | 0.2 | -1.0 | -0.6 | 15.8 | 41.7 | 14.2 | 14.9 | 1.1 | 1.1 | 6.1 | 8.0 | 2.8 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 8.7 | 8.9 |
| | Resonac | 7.2 | -0.8 | 0.6 | 26.9 | 62.8 | 131.3 | 35.4 | 15.3 | 1.6 | 1.5 | 11.2 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 4.7 | 10.6 |
| | Siltronic | 1.9 | -0.1 | 0.5 | 36.5 | 31.3 | 64.7 | N/A | N/A | 0.9 | 0.9 | 9.5 | 7.1 | 1.5 | 1.7 | -0.1 | -0.0 | 0.4 | 0.5 | -4.2 | -5.1 |
| | Sumco | 4.0 | 1.6 | 3.0 | 21.2 | 38.1 | 90.0 | N/A | 258.7 | 1.0 | 1.0 | 7.9 | 6.1 | 2.7 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | -0.6 | 0.5 |
| | Dell | 102.3 | -1.6 | -3.0 | 18.5 | 22.4 | 81.5 | 16.1 | 13.5 | N/A | 218.9 | 10.4 | 9.3 | 106.4 | 116.3 | 8.1 | 10.6 | 11.7 | 12.8 | -334.8 | 202.8 |
| | HPE | 29.7 | -10.1 | -14.3 | -7.9 | 10.6 | 51.2 | 11.6 | 9.2 | 1.2 | 1.1 | 7.7 | 6.0 | 35.9 | 41.2 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 7.3 | 11.1 | 12.2 |
| | Lenovo | 18.4 | -0.9 | -8.4 | -3.7 | 13.3 | 42.5 | 14.0 | 11.1 | 2.6 | 2.2 | 5.6 | 4.1 | 75.8 | 81.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 4.4 | 23.9 | 23.6 |
| | Quanta | 36.8 | 1.9 | -4.7 | 6.8 | 7.6 | 26.7 | 16.2 | 13.7 | 5.2 | 4.6 | 11.9 | 10.4 | 70.4 | 92.8 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 31.0 | 33.6 |
| Server | Inspur | 13.9 | -0.5 | -11.3 | 3.6 | 21.9 | 43.1 | 35.6 | 27.5 | 4.4 | 3.8 | 30.3 | 24.6 | 22.4 | 27.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 12.5 | 14.0 |
| | Wiwynn | 23.4 | 1.7 | 12.4 | 22.2 | 57.2 | 105.3 | 16.3 | 14.9 | 6.3 | 5.5 | 11.5 | 10.7 | 28.1 | 33.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 42.9 | 38.9 |
| | Inventec | 5.1 | 0.9 | -6.6 | 2.5 | 3.2 | 8.4 | 18.9 | 15.3 | 2.3 | 2.2 | 11.4 | 10.9 | 22.3 | 24.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 11.9 | 13.7 |
| | Mitac | 4.0 | 1.6 | 2.1 | 10.0 | 45.4 | 104.0 | 22.6 | 13.7 | 2.0 | 1.7 | 18.3 | 10.7 | 3.5 | 5.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 9.5 | 13.2 |
| | Amazon | 2287.3 | -0.5 | -5.8 | -8.4 | -3.9 | 23.0 | 25.8 | 23.5 | 6.2 | 5.1 | 14.2 | 12.2 | 708.8 | 782.6 | 80.0 | 97.7 | 166.4 | 197.0 | 21.8 | 19.7 |
| | Microsoft | 3802.9 | -0.4 | -2.1 | 0.5 | 1.2 | 37.7 | 35.0 | 30.7 | 9.5 | | | | | | | | | | | |

ASML 홀딩 관련 용어

| 용어 | 이미지 | 설명 |
|---------------------------|---|--|
| MUV (Mid-Ultraviolet) | | 파장 길이가 365~200nm인 자외선을 사용하는 노광 기술 |
| I-line |  | 파장 길이가 365nm인 자외선을 활용한 노광 장비 |
| KrF (Krypton Fluoride) |  | 파장 길이가 248nm인 심자외선을 활용한 노광 장비. KrF 레이저를 사용 |
| ArF (Argon Fluoride) |  | 파장 길이가 193nm인 심자외선을 활용한 노광 장비. ArF 레이저를 활용하며, 공기를 사용하는 건식 공정 장비 |
| ArF Immersion |  | 파장 길이가 193nm인 심자외선을 활용한 노광 장비. (rF)레이저를 활용하며, 물을 사용하는 습식 공정 장비 |
| DUV (Deep Ultraviolet) | | 파장 길이가 193nm인 심자외선을 사용하는 노광 기술 |
| EUV (Extreme Ultraviolet) | | 파장 길이가 13.5nm인 초미세 자외선을 사용하는 노광 기술 |
| High-NA EUV |  | 0.55NA의 High-NA(Numerical Aperture, 고 굴절율) 렌즈를 활용한 최신 EUV 장비 High-NA: 기존 EUV 대비 렌즈 크기 확대, 더 미세하고 정밀한 패턴 구현 가능 |
| Metrology & Inspection |  | 웨이퍼에 새겨진 패턴의 품질을 검사하는 계측 및 검사 장비 |
| Installed Base Management | | 고객사의 기존 장비에 대한 서비스 및 업그레이드 등을 제공하는 사업 부문 |
| WPH (Wafer per Hour) | | 장비가 1시간에 처리할 수 있는 웨이퍼 수를 나타내는 반도체 제조의 핵심 지표 |
| NA (Numerical Aperture) | | 렌즈가 포착할 수 있는 빛의 최대 각도를 나타내는 수치. 값이 높을수록 해상도 향상 |
| Resolution | | 인접한 두 대상을 얼마나 자세하게 구분할 수 있는지를 나타내는 능력인 분해능을 의미 |
| Multi Patterning | | 미세 공정을 위해 필요한 여러 번의 패터닝 작업 과정. DUV 장비 활용 |
| Single Exposure | | 단일 노광으로 패터닝을 마치는 작업 과정. EUV 장비에서 활용 |
| Lithography | | 실리콘 웨이퍼에 회로 패턴을 형성하는 공정 |
| Lithography Intensity | | 리소그래피 장비가 반도체 제조 공정에서 차지하는 비용의 비율을 의미 |

자료: ASML 홀딩, 키움증권 리서치센터

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- "ASML 홀딩" 종목은 10월 13일 해외관심종목에 언급된 바 있습니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.